

2023年3月29日

各 位

J X 金属株式会社

台湾拠点における半導体用スパッタリングターゲットの生産能力の増強について

J X 金属株式会社（社長：村山誠一、以下「当社」）の子会社である台湾日鉱金属股份有限公司（総経理：宇野博司、以下「台湾日鉱金属」）は、半導体用スパッタリングターゲットの加工設備の増強を行い、同拠点における生産能力を現行から約80%引き上げることといたしました。今後、新規ラインの設計・建設・立上げを行い、2024年度下期以降、随時稼働予定です。

当社グループの半導体用スパッタリングターゲットは、最先端のロジックやメモリなどをはじめ、各種半導体デバイスの製造に用いられています。当製品は業界トップのシェアを有しており、「2040年J X 金属グループ長期ビジョン」において「フォーカス事業」として位置付けている先端素材分野の主力製品のひとつです。

世界的なデジタル化進展に伴って半導体産業の拡大が進み、長期的な観点で需要増が見込まれることから、現在当社グループでは国内外で当製品の生産能力の増強を行っております。この一環として、最先端半導体の生産拠点である台湾においても、従来比2倍の能力とするための設備投資を今年度に完了いたしました。同地域の将来的な需要増を見据え、今般、これにさらに上積みして生産能力増強を行うことを決定いたしました。本投資を通して顧客からの要請に機動的に対応できる供給体制を構築し、信頼に応えてまいります。

これからも当社グループは、「2040年J X 金属グループ長期ビジョン」で掲げる「技術立脚型企业」への転身に向けた施策を推し進め、先端素材で社会の発展と革新に貢献するグローバル企業を目指してまいります。

以 上



台湾日鋇金属

(参考)

台湾日鋇金属股份有限公司について (2023年3月29日現在)

会社名	台湾日鋇金属股份有限公司
所在地	桃園市龍潭区龍園一路 88 號
代表者	総経理：宇野博司
資本金	63.5 百万台湾元
事業内容	電子材料製品の製造および販売、金属加工製品のスリット・販売、工業品の販売、金属スクラップおよび故銅等の集荷・販売